

Pressemitteilung

## **POLYRACK auf der embedded world 2019: Gehäuse- und Systemapplikationen für individuelle Anforderungen**

Halle 3, Stand 349

**Straubenhardt, 12. Dezember 2018 – Die POLYRACK TECH-GROUP präsentiert vom 26. Februar bis 28. Februar 2019 auf der embedded world in Nürnberg (Halle 3, Stand 349) neben einer Vielzahl an Gehäusesystemen auch kundenspezifische Systemapplikationen aus verschiedenen Branchen und Einsatzgebieten inklusive Elektronikintegration und Auswahl von HMI- und MMI-Anwendungen.**

Für den Embedded-Bereich, insbesondere für industrielle Umgebungen, präsentiert POLYRACK die **PanelPC 2**-Serie. Diese Panel-PC-Lösungen der Schutzklasse IP54 sind in Größen von 10,1“ bis 21,5“ sowie in unterschiedlichen Materialvarianten von gefrästem Aluminium bis hin zur Blechbiegelösung verfügbar. Als Bedienoberfläche stehen resistive Single-Touch- oder Multi-Touch-fähige kapazitive Touchscreens (PCAP) in unterschiedlichen Glasstärken zur Auswahl. Kundenspezifische Bedruckung und Anti-Fingerprint-Beschichtungen sind auf Wunsch möglich. Um die Vorteile unterschiedlicher Werkstoffe zu nutzen, stehen Kunden für die Realisierung individueller Anforderungen außerdem weitere Technologien zur Materialauswahl zur Verfügung, wie z.B. Kunststoff und Guss - auch in Materialkombination.

**Small Form Factor mit EmbedTEC:** Das Aluminium-Tischgehäuse ist die elegante Verpackung für kleine Formfaktoren wie embedded NUC (eNUC), pico-ITX (pITX, 2,5“), SMARC, QSeven und SBCs wie den Raspberry Pi. Es verfügt über ein austauschbares I/O-Shield und

einen massiven Aluminiumdeckel zur Wärmeabfuhr. Für höhere Leistungen lässt sich dieser durch einen Kühlkörper ersetzen, perforierte Seitenwände und Ventilatoren steigern die Kühlleistung bei Bedarf nochmals. Für Anwendungen im Bereich Automatisierung und IoT bietet POLYRACK zudem vielfältige Anpassungen und Montageoptionen.

Weitere Gehäuseserien wie **SmarTEC** für hochwertige Systeme wie passiv gekühlte Mini-PCs, **EmbedTEC** für Embedded Computing und HMI-Anwendungen sowie **Backplanes** für den High-Speed-Bereich mit den Standards VPX und CompactPCI Serial vervollständigen das Portfolio des Gehäusespezialisten POLYRACK. Alle Lösungen zeichnen sich durch passendes Zusammenspiel von Mechanik, Kunststoff, Elektronik und dem Oberflächenfinish aus – abgestimmt auf den Zielmarkt.

#### Bilder:



Bild 1: Die PanelPC 2-Serie steht in unterschiedlichen Displaygrößen und Bedienoberflächen zur Auswahl.



Bild 2: EmbedTEC für Small Form Factor (SFF)

###

#### Über die POLYRACK TECH-GROUP ([www.polyrack.com](http://www.polyrack.com))

Die POLYRACK TECH-GROUP entwickelt und produziert hochqualitative Systemlösungen für die Elektronik. Dank breitem Technologiespektrum in der mechanischen Fertigung, Systemtechnik/ Elektronik, Kunststofftechnik und Oberflächenbearbeitung bietet POLYRACK Electronic Packaging für jeden Bedarf. Das Leistungsangebot reicht von der Beratung in der Konzeptionsphase über die Entwicklung, Produktion und Assemblierung bis hin zu Logistiklösungen und Sourcing Services.

Die Unternehmensgruppe umfasst die POLYRACK Electronic-Aufbausysteme GmbH, die RAPP Kunststofftechnik GmbH, die RAPP Oberflächenbearbeitung GmbH sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, Belgien, Amerika und China. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 440 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 65 Millionen Euro in der Gruppe.

**Pressekontakt:**

POLYRACK TECH-GROUP, Maximilian Schober,  
Tel: +49 7082 7919-771, e-Mail: [maximilian.schober@polyrack.com](mailto:maximilian.schober@polyrack.com)

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations, [www.lorenzoni.de](http://www.lorenzoni.de)  
Christine Schulze, Tel: +49 8122 55917-14,  
e-Mail: [christine@lorenzoni.de](mailto:christine@lorenzoni.de)